

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	利扬芯片 2025 年第三季度业绩说明会
时间	2025 年 12 月 1 日 10:00-11: 00
地点/方式	上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com ） 网络文字互动
参会人员	董事长：黄江 董事、总经理：张亦锋 董事、董事会秘书兼财务总监：辜诗涛 独立董事：郭群
投资者关系 活动主要内容介绍	一、投资者网络文字互动环节 （1）公司本期有分红吗？ 尊敬的投资者，您好。公司 2025 年第三季度无分红计划，后续是否有分红可留意公司相关公告。感谢您对公司的关注。 （2）公司在研发上有什么规划，目前有多少专利，研发占比如何？ 尊敬的投资者，您好。公司正在研发的项目包括“高像素 CMOS 图像传感器的芯片测试方案研发”“高性能机器人视觉处理芯片测试方案研发”“第一代 AI 算力芯片测试平台研发”“高带宽射频芯片晶圆量产测试方案研发”“车身控制芯片可靠性测试方案研发”“电机传感器芯片测试方案研发”“HBM 存储芯片集成化测试系统与软件协同开发”和“宽禁带半导体器件测试方案研发”等。 未来公司将加大力度继续布局汽车电子、工业控制、高算力（CPU、GPU、AI 等）、传感器（MEMS）、存储（Nor/Nand Flash、DDR、HBM 等）、无人驾驶、机器人等领域方向的研发投资。截止

	2025 年半年度，公司拥有专利及软件著作权累计共 298 个；截止 2025 年 1-9 月，公司研发占比 12.89%，感谢您对公司的关注。 （3）黄总：您好！公司在与那家气车玻璃生产商合作，具体合作的内容可以介绍一下吗？谢谢！ 尊敬的投资者，您好。公司未直接与汽车玻璃生产商合作，但公司一体两翼战略布局的左翼晶圆减薄、激光隐切技术，目前激光隐切技术可完成 0.2*0.2mm² 划片道 20 μ m 的量产，未来可应用于汽车玻璃全息隐形屏等创新应用，具体内容涉及商业保密信息，不方便透露，后续可留意公司相关公告，感谢您对公司的关注。
--	--